**2023年度苏州工业园区集成电路产业发展专项资金申报书**

（2.1 支持企业融资）

一、项目基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 注册时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| “6+2”发展方向 | 六大主赛道：[ ] 集成电路芯片设计 [ ] 高端制造[ ] 先进封测 [ ] 关键设备[ ] 核心材料 [ ] 自主软件两大特色领域：[ ] 微机电系统（MEMS）[ ] 第三代半导体 |
| 企业介绍及主营业务概述（300字以内） |  |
| 财务发展情况 | 指标/年份 | 2021年 | 2022年 |
| 营业收入（万元） |  |  |
| 专利数量（个） |  |  |
| 首轮融资总额（万元） |  |
| 首轮融资机构实缴金额（万元） |  |
| 首轮融资完成日期 |  |
| 首轮机构投资方 |  |
| 企业股权变更登记记录（从注册开始） | 时间、股东、比例、注册资本变化情况等 |
| 下一轮融资计划 |  |

二、企业及项目介绍

包括企业团队构成、技术产品能力、未来发展计划等。

三、首轮融资知名股权机构简介（及入选榜单证明材料）